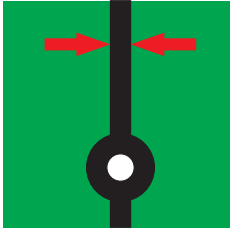


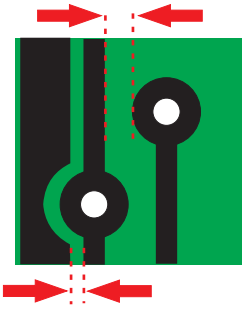


## SPECIFICHE TECNICHE MINIME DI LAVORAZIONE



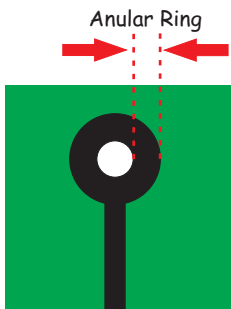
Dimensione minima delle piste su pcb da 35 micron 0.18 mm (7 mils)

Dimensione minima delle piste su pcb da 70 micron 0.30 mm (12 mils)



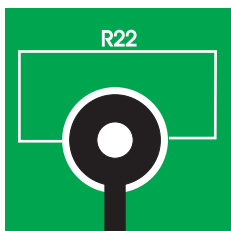
L'isolamento minimo tra le pad e le piste deve essere di 0,18 mm (7 mils).  
Dove possibile si consiglia di usare isolamenti superiori a 0,20 mm (8 mils)

L'isolamento minimo tra i piani di massa le pad e le piste deve essere di 0,20 mm(8mils) .Dove possibile si consiglia comunque di usare un isolamento non inferiore a 0.25 mm (10 mils)



Minimo diametro di foratura 0.40 mm (16 mils)  
Minimo diametro di fresatura 0.80 mm (32 mils)  
Distanza minima tra i fori 0.40 mm (16mils)

L' Anular Ring non deve essere inferiore a 0.20 mm (8mils) per i vias e 0.25 mm (10 mils)per il resto delle piazzole. Nel caso di fresature all'interno dei pad l'anular ring non deve essere inferiore a 0.50 mm (20 mils)



Le pad del solder mask devono essere più grandi delle pad del circuito di 0.20 mm (8mils)  
La distanza tra la serigrafia e il rame è opportuno che non sia inferiore a 0.20 mm (8 mils)  
Le dimensioni del tratto della serigrafia non deve essere inferiori a 0.15 mm (6 mils)

PS: Per pcb con specifiche al di sotto dei valori sopra elencati bisogna valutare prima la fattibilità di realizzazione della scheda. Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente allo 0924 25200 oppure al 388 8066418.